

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

公告编号：2026-016

## 龙芯中科技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2026年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）前次募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕646号文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,100.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币60.06元/股，募集资金总额为246,246.00万元，各项发行费用总额为4,252.11万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为241,993.89万元。

公司实际收到的募集资金金额243,931.29万元于2022年6月21日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天职业字[2022]35349号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

公司或公司全资子公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2026年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行	110905928210821	-	-	活期存款
中信银行股份有限公司北京分行营业部	8110701012702292680	-	-	活期存款
中信银行股份有限公司北京丰台支行	8110701013802337056	-	-	活期存款
招商银行股份有限公司北京海淀支行	125910822410608	-	-	活期存款
中国民生银行股份有限公司北京南二环支	682058558	243,931.29	-	已注销

行（注1）				
合计	-	243,931.29	-	-

注1：为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定将中国民生银行股份有限公司北京南二环支行专项账户 682058558 注销。公司在 2022 年 8 月已完成上述募集资金专户注销手续。上述募集资金账户注销后，公司与该募集资金专户开户银行、保荐机构中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

## 二、前次募集资金使用情况

截至 2026 年 03 月 31 日，本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为 241,993.89 万元（实际投资金额为 246,845.76 万元，4,853.28 万元为利息收入，1.42 万元为银行手续费支出），前次募集资金净额及扣除银行手续费后的利息收入均已被全部用于前次募集资金投资项目，前次募集资金存储专户的银行余额均无余额。

本公司前次募集资金实际使用情况，详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

## 三、前次募集资金变更情况

本公司于 2024 年 6 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，根据相关募投项目实际情况，经过谨慎的研究论证，公司调整部分募投项目内部投资结构，“先进制程芯片研发及产业化项目”拟使用的募集资金增加投资 15,000.00 万元，“高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目”拟使用的募集资金调减投资 15,000.00 万元，并将上述两个募投项目达到预定可使用状态的时间均延期至 2025 年 6 月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于部分募集资金投资项目延期及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（2024-020）。

本公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分集资金投资项目延期的议案》，根据公司募投项目的实际建设情况和投资进度情况，经过谨慎的研究论证，决定对公司部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期，拟将募投项目“先进制程芯片研发及产业化项目”、“高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目”达到预定可使用状态的时间由 2025 年 6 月调整至 2026 年 6 月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2025-009）。

截至 2026 年 3 月 31 日，除上述情况外，本公司不存在其他变更募投项目的情况。

## 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

本公司于2022年7月8日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，为提高募集资金使用效率及公司日常运营资金周转，公司使用募集资金合计人民币12,735.25万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具天职业字[2022]35856号《关于龙芯中科技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。具体内容详见公司于2022年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（2022-004）。

公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用基本存款账户支付募投项目人员及材料费用并以募集资金等额置换的议案》，公司根据募投项目实施的具体情况，使用基本存款账户支付募投项目人员及材料费用并定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于使用基本存款账户支付募投项目人员及材料费用并以募集资金等额置换的公告》（2025-011）。

## 五、前次募集资金投资项目实现效益的情况

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目”尚在建设期，项目旨在提升公司的研发能力，不直接产生效益，但通过项目的建设公司进一步提高通用图形处理器产品及其软硬件研发能力，进一步掌握通用GPU IP核的关键核心技术，与公司的CPU产品形成协同效应，从而间接提高公司收益。

“补充流动资金”无法单独核算效益。本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

### （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

截至2026年3月31日，本公司未对前次募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

## 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。

## 七、闲置募集资金的使用

为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

公司于2022年7月8日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，计划使用最高余额不超过人民币20亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年7月9日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-003）。

公司于2023年7月3日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，计划使用最高余额不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年7月4日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《龙芯中科关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2023-027）。

公司于2024年8月13日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，计划使用最高余额不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年8月14日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《龙芯中科关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-033）。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，计划使用最高余额不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《龙芯中科关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-010）。

截至2026年3月31日，本公司合计使用739,700.00万元（募集资金循环滚动使用累计金额）进行现金管理，全部用于购买结构性存款，已到期739,700.00万元，未到期0.00万元。获得现金管理的资金收益共计4,319.57万元。

## 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2026年3月31日，本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为

246,845.76万元，募集资金净额结余金额为0.00万元。

#### 九、前次募集资金使用的其他情况

本公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

龙芯中科技术股份有限公司董事会

2026年5月28日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：龙芯中科技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

<p>募集资金总额：241,993.89[注 1]</p> <hr/> <p>变更用途的募集资金总额：[注 2]</p> <p>变更用途的募集资金总额比例：不适用</p>	<p>已累计使用募集资金总额：241,993.89（实际投资金额 246,845.76 万元，4,853.28 万元为利息收入，1.42 万元为银行手续费支出）</p> <p>各年度使用募集资金总额：</p> <p>2022 年：148,611.93（实际投资金额 149,619.21 万元，1,007.41 万元为利息收入，0.13 万元为银行手续费支出）</p> <p>2023 年：25,407.65（实际投资金额 27,877.04 万元，2,469.69 万元为利息收入，0.30 万元为银行手续费支出）</p> <p>2024 年：37,094.36（实际投资金额 38,159.33 万元，1,065.39 万元为利息收入，0.42 万元为银行手续费支出）</p> <p>2025 年：28,461.82（实际投资金额 28,770.56 万元，309.25 万元为利息收入，0.52 万元为银行手续费支出）</p> <p>2026 年 1-3 月：2,418.13（实际投资金额 2,419.62 万元，1.53 万元为利息收入，0.04 万元为银行手续费支出）</p>
---	--

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	先进制程芯片研发及产业化项目	先进制程芯片研发及产业化项目	125,760.45	85,000.00	87,327.12	125,760.45	85,000.00	87,327.12	2,327.12	2026 年 6 月
2	高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目	高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目	105,426.45	36,993.89	39,518.64	105,426.45	36,993.89	39,518.64	2,524.75	2026 年 6 月
3	补充流动资金	补充流动资金	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	不适用
	合计	——	351,186.90	241,993.89	246,845.76	351,186.90	241,993.89	246,845.76	4,851.87	——

注 1：此处填报的为扣除发行费用后的募集资金净额 241,993.89 万元；

注 2：详见本专项报告“三、前次募集资金变更情况”内容；

注 3：实际投资金额超过承诺投资金额的原因是公司使用账户内产生的利息收入扣除银行手续费后的净额进行投资；

注 4：本表中明细数据加总与合计数据不一致，均为小数点四舍五入所致。

附件 2:

## 募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益					截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年 1-3 月		
1	先进制程芯片研发及产业化项目	不适用	不适用	建设期, 不适用	建设期, 不适用	建设期, 不适用	建设期, 不适用	建设期, 不适用	建设期, 不适用	建设期, 不适用
2	高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用